

“亿”正在成为芯片企业融资的量词标准用法。

2021年已经没有机构不投半导体。不止一位芯片企业的高管告诉我，很多机构都没见到CEO的情况下，仅凭一个电话，就会发出价值数亿的TS。

“不尽调是普遍现象，抓紧发TS也只是为了抢项目。”

以“亿”来计量的融资几乎天天在官宣：芯启源、芯耀辉、摩尔线程、亿咖通、星思半导体、天数智芯、长芯盛智、沐曦集成电路、芯河半导体、地芯科技、合肥长鑫.....

相关数据显示，截止到2020年9月1日，国内半导体企业数量累计已经超过5万家，在各种VC、PE、半导体产业基金的扶持投入下，全国半导体产业投资金额已经超过了5000亿大关。

但可堪玩味的情况是，从2020年12月初至2021年3月初，共有13家拟上市芯片企业的IPO中止或终止，其中也不乏依图科技、云知声等知名度较高的明星企业。

一边是二级市场劝退13家芯片企业，一边则是天天宣布数亿的投资狂潮，行业整体利好的大背景下，芯片资本市场一时冰火两重天。

密集再密集的融资

对于芯片企业，现在确实是融资好时机。

单就汽车芯片而言，美国MarketResearch Future预测，在2018-2023年间，全球汽车芯片市场的复合年增长率为12.87%，且市场估值可以增长到724.286亿美元。

具体到国内而言，2020年全球汽车芯片规模约为3000亿元，中国自主汽车芯片产业仅70亿元，市场占比小于2.5%。

2020年下半年开始，从全球汽车“缺芯潮”开始蔓延，汽车巨头为此减产减售。并且短缺已经波及到了智能手机和游戏机，比如华为手机比茅台还难抢，小米旗下的小米11也处于日常缺货的状态。

也因此，无论是大体量的芯片巨头，还是刚刚收拢团队正在找融资的初创公司，无一例外都在狂揽投资。

《2020年中国半导体行业投资解读》报告中显示，2020年成为中国半导体一级市

场有史以来投资额最多的一年，投资金额超过1400亿元，相比2019年增长近4倍。此外，C轮以后的投资比重大幅增加，从17.5%增加到28.1%，投资机构不仅“扶上马”更愿意“送一程”。

以地平线为例，2020年12月宣布启动超7亿美元的C轮融资，同时宣称已完成由五源资本（原晨兴资本）、高瓴创投、今日资本联合领投的C1轮1.5亿美金融资，两周后的1月7日，其又宣布完成Baillie Gifford、云锋基金、中信产业基金、宁德时代联合领投的4亿美元C2轮融资。

紧接着，2月9日，其又宣布完成C3轮3.5亿美元融资，其中不仅获得国投招商、中金资本旗下基金、众为资本等顶级机构的重磅投资，还获得众多汽车产业链上下游明星企业的战略加持。截至到目前，地平线C轮融资共计达到9亿美元，超过预定目标。

多位汽车行业投资人遗憾地表示，太抢手了，没抢到地平线的股权。随着芯片供应紧张，地平线的估值不断上涨。2019年B轮融资时估值约30亿美元；2020年底启动C轮融资时，投前估值35亿美元。

创业企业也一连串地宣布融资：

2月23日，芯启源宣布完成数亿元Pre A2轮融资，和利资本领投；

2月24日，芯耀辉宣布完成由红杉中国、高瓴创投、云晖资本和高榕资本等联合投资Pre-A轮融资，而截止于此，其总融资金额已超4亿元；

2月25日，成立100天的摩尔线程宣布已完成由深创投、红杉资本中国基金、GGV联合领投的共计数十亿元的两轮融资；

同是2月25日，亿咖通科技（ECARX）宣布完成由中国国有资本风险投资基金领投的超过2亿美元A+轮融资，此轮融资完成后，亿咖通科技的整体估值突破20亿美元；

还是2月25日，星思半导体宣布已完成近4亿元Pre-A轮融资。本轮融资由鼎晖VGC领投；

3月1日，天数智芯宣布完成由运柏资本和大钲资本联合领投的12亿元C轮融资；

也是3月1日，长芯盛智连获得近3亿元A轮融资，本轮融资由昆桥资本领投；

3月8日，沐曦集成电路宣布完成由光速中国和经纬中国联合领投的PreA+轮融资，此前11月刚宣布完成近亿元天使轮融资，且该公司2020年9月刚刚成立；

还是3月8日，芯河半导体宣布已完成数亿元Pre-A轮融资。该轮融资由恒信华业领投，冯源资本、临芯投资等跟投，这也是其成立一年多以来，完成的第二轮过亿人民币的融资。

3月9日，地芯科技宣布完成近亿元A轮融资，英华资本领投，老股东瑞芯微电子、岩木草投资跟投；1月初，其刚刚完成了英诺天使基金、青松基金和华睿投资等上一轮融资；

合肥长鑫也在本月初传出消息，正在启动超过百亿级的融资，甚至可能达到200亿元；但就在2020年12月，其母公司睿力集成电路有限公司已完成156亿元融资，投资方包括“大基金”二期、安徽国资、兆易创新、小米长江产业基金等机构和龙头公司。

与此同时，已经上市的芯片公司则吃尽2020年的红利。这一年共有32家半导体公司上市，达到有史以来最高，市值大多在50-100亿元之间。整个半导体行业的公司平均市值增长40%-50%。

毕竟，国务院于2020年8月出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，多处提及加快攻克集成电路中“卡脖子”技术，并提到2025年我国的芯片自给率需达到70%。按照2025年7000亿美元的需求和70%的自给率折算，中国需自产4900亿美元的芯片。

2021年芯片融资开门红，只是赛道好戏的开始。

谁都怕抢不到

撒钱式投资的背后，是机构对入场券的争夺。

根据统计数据显示，2020年上半年，国内已经上市的半导体企业在通过各种融资方式，募资筹集了超过380亿美元资金，约人民币2500亿元，而国内还有很多非上市的半导体企业，在各种VC、PE、半导体产业基金的扶持投入下，全国半导体产业投资金额已经超过了5000亿大关。

争夺更为激进的是产业链上下游的相关机构。

根据中国证券报等媒体报道，3月5日当天OPPO完成了对功率半导体领域企业威兆

半导体的投资；同时芯片厂商联发科发布公告称OPPO将投资射频前端企业唯捷创芯。

2018年以来，OPPO在芯片领域的投资就在不断加速，旗下公司上海瑾盛通信经营范围增加集成电路芯片设计，先后入股上海南芯半导体、上海瀚巍微电子、广东微容电子科技等等，并出资5000万元参股深圳一只半导体投资基金，投资半导体企业长晶科技。

至于小米，单单2月，就已经出手了两家芯片企业。且据不完全统计，小米长江产业基金投资的来自芯片领域相关企业高达40多家，已上市或披露招股书的公司有方邦股份、芯原股份、创鑫激光、利和兴、格科微等公司。

华为哈勃在过去一年，同样投资了至少21家半导体公司。且对于华为和小米来说，都在半导体材料、芯片设计、半导体设备等产业链上的各个环节进行布局，甚至还有多家公司为共同投资，比如纵慧芯光、好达电子、昂瑞微、思特威是两家都投资的项目。

长城汽车对地平线的战略投资则更加直接了当，其对外宣传，这标志着长城汽车正式进军芯片产业。长城汽车将通过战略投资、战略合作及自主研发等方式，在芯片产业快速发展。

追求财务投资的VC/PE也在大踏步进场。

启明创投合伙人叶冠泰告诉我，2004年刚刚进入VC行业的时候，就在英特尔投资部看半导体，也做了成功的投资，而现在，他又开始看半导体了。

“近两三年来，中国对半导体行业的重视程度上升到了国家级的最高级别。在国家政策的大力支持下，尽管全球半导体行业今年是下滑的，但中国的半导体行业是上升的。当然，从全行业而言，过去十年、二十年都是这样的情况。”

高瓴创投2020年在半导体芯片、量子与航天在内的硬科技项目上做了系统性布局，投资的项目包括芯耀辉、芯华章、星思半导体、国仪量子、地平线、Zilliz等等。

云岫资本管理合伙人兼首席执行官高超在接受经济观察报时就表示，在一级市场长期投半导体项目的机构约有20家，但最近一年，无论产业基金、财务投资机构，还是国资背景机构，都在看半导体，数量至少有上千家。

“2019年的科创板全面引爆了半导体行业的风险投资。目前，科创板已经有数十家半导体公司上市。据统计数据，仅以首次募集资金计算，科创板向22家半导体企业

共输血超700亿元。科创板的“财富效应”提醒了一二级市场，原来投半导体这么赚钱。”

当然，这背后也少不了国家队的持续关注 and 投入。

3月2日，国家开发银行董事长赵欢在国新办新闻发布会上就表示，今年准备新增股权投资500亿元以上，将运用开发银行管理的产业投资基金、科创基金，继续加大对集成电路、先进制造业以及科技创新方面的股权投资力度。

赵欢表示，子公司已经完成了大基金的一期投资，同时，也参与了国家集成电路产业投资基金二期的设立工作，募集了2000亿资金，现在已经全面进入了投资阶段。此外，2021年，该行计划对战略新兴产业、先进制造业两个行业投放4000亿元以上的贷款。

在集成电路芯片制造业，国开行子公司参与发起成立的国家集成电路产业基金（简称“大基金”），是业内规模最大、最具风向标意义的股权投资基金。该基金一期资金规模约1300亿元，目前已募集二期资金，将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等半导体设备领域进行高强度支持。

可谓是弹药充足，只待项目蓬勃发展。

“互联网”投法，还是长期主义？

大举投资背后，也不是没有值得担心的问题。

在芯片国产化的热潮之下，企业如雨后春笋般冒出，以芯片的名义骗取政府补贴和融资的现象时有发生。而一旦发生资金链断裂，这些企业留下的芯片项目便成了一地鸡毛，像弘芯这样的亿级烂尾项目也不在少数。

当然也有很多企业产品落地。包括难度比较大的GPU初创企业，登临科技已宣布其首款产品成功回片并客户送样，天数智芯宣布其7nm GPGPU计算芯片BI已于11月回片、12月成功“点亮”等，不断来稳定市场的期待。

只是，从产品定义到设计、流片，芯片的制造周期普遍在18-24个月左右。目前，这些企业大多处在成立初期，产品大规模落地的并不多，更多还需要时间的验证。

相对低端的射频等领域，虽然有大量企业冒头，但为了争夺有限的客户，一再进行价格战，射频芯片行业的利润空间不断被挤压，显然就不适合再做创业和投资了。

因此，一方面有投资人呼吁集中力量办大事，另一方面，也有产业人士劝投资人要考虑清楚。

“VC一窝蜂投资PA射频芯片的创业公司,最终PA芯片的毛利率变成20%,原本是一项高科技,做到毛利20%,这是很可悲的事。”华登国际合伙人王林在一次半导体创业投资论坛上表示。

在他看来，一级市场资本的不理性、不合理的投资正在分散半导体行业的资源，随着诸多百人规模以下的中小公司涌入该领域，很多VC机构跟进，这导致VC资金和半导体人才被分散化。

也因此，王林表示，应该聚集多家资本的力量支持一家公司。他举例称，例如一家国产企业要做成GPU，可能需从10亿美金起步，机构只有集中资源扶持一家公司，抱团取暖，只要团队足够优秀，长期坚持一定能获得回报，并实现国产化的目标。

比如，最近10年来，中国芯片史上最大的融资额，为2017年紫光集团融资的1500亿，当时由华芯投资，国开行注资，紫光集团获得了1500亿元的投资。

但也正是有了这笔投资，紫光集团先后收购了展讯通信、锐迪科，再走出国门与西部数据建立合资企业，后来更是注资成立了长江存储，成了目前国内最大的存储基地。

接受投中网采访时，澜起科技创始人杨崇和表示，作为一家高科技公司，特别是想做硬科技的公司，最重要的是技术和产品过硬。

“现在高回报的项目很多，骗局也很多，所以投资人要稍微冷静下，互联网投资的玩法现在影响到了芯片企业，短时间融很多轮拿很多钱，但每个产业特征是不一样的，芯片产业并不是能像互联网一样快速起来的产业。我们都要尊重企业的客观发展规律，对于芯片行业来说，其有自身的发展规律，互联网赚钱的方案，不太容易能照搬过来。”